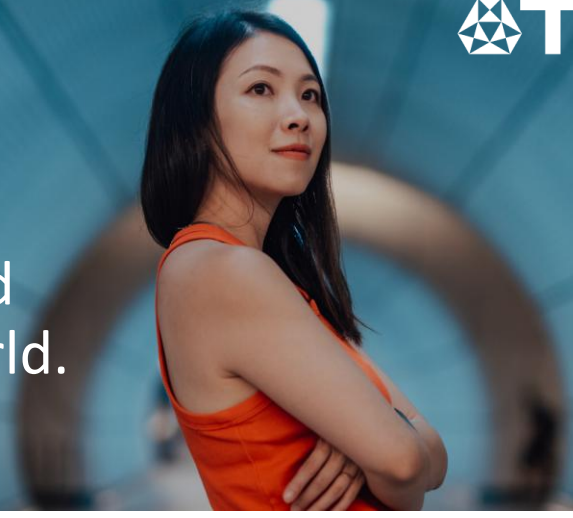




What you build
moves the world.



Wir suchen einen

Prozesstechniker – Bonden (m/w/d)

►► Deutschlandsberg, A

Über uns

Passive elektronische Bauteile sind in fast allen elektrischen und elektronischen Geräten zu finden und für deren einwandfreie Funktion unverzichtbar.

TDK ist ein weltweit führender Hersteller dieser Schlüsselprodukte.

Deine Qualifikationen

- Abgeschlossene technische Hochschulausbildung (TU, FH o.ä.) mit Schwerpunkt Physik, Chemie, Maschinenbau o.ä.
- Einschlägige Berufserfahrung im industriellen Umfeld wünschenswert
- Erfahrung mit CAD, Programmierkenntnisse (Python) sowie Erfahrung mit Six-Sigma-Methoden vorteilhaft
- Strukturierte, lösungsorientierte und selbstständige Arbeitsweise
- Ausgeprägte Hands-on-Mentalität
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Bereitschaft zur Arbeit in Reinraumumgebung

Dein Verantwortungsbereich

- Verantwortung für das Prozessmodul „Bonding Technologies“ im Bereich Wafer-Level Packaging
- Betreuung von Produktions- und R&D-Projekten
- Entwicklung, Optimierung und Parametrisierung von Wafer-Level- und Flip-Chip-Bondprozessen
- Erstellung von Messprogrammen sowie Datenanalysen (Versatz-, CD-Messungen)
- Konzeptentwicklung für Wafer-Rekonstruktion mittels Flip-Chip-Bond-Technologie
- Mitwirkung bei der Lastenhefterstellung sowie Erstellung von Maschinen- und Prozessfreigaben
- Kommunikation und Abstimmung mit Anlagenherstellern sowie Übernahme der Expertenrolle in Kundenprojektmeetings
- Enge Zusammenarbeit mit anderen Prozessmodulen, der IT und der Qualitätssicherung

Das erwartet dich



Tarifgebundenes Unternehmen



Flexible Arbeitszeiten



Karriereförderung & Weiterbildung



Kantine



Sport- und Gesundheitsangebote

...und vieles mehr!



Gehalt:
ab € 4.500 brutto/Monat (14x) mit der Bereitschaft zur Überzahlung in Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung

